

## 新产品：Welco AP519 T6号粉 低温免清洗型印刷焊锡膏

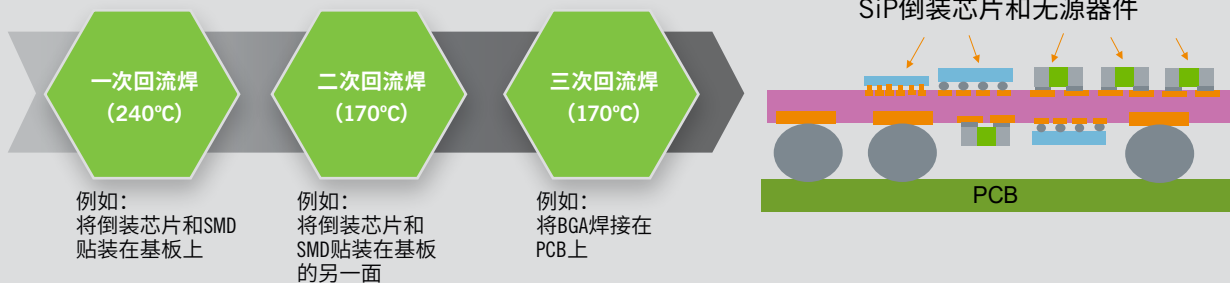
Welco AP519 T6焊锡膏采用贺利氏专有的Welco锡粉配制而成，是一款技术先进的低温免清洗型无铅锡膏。该产品专为回流焊峰值温度不超过170°C的细间距半导体封装工艺而设计，包括用于系统集成封装（SiP）和器件叠层封装（PoP）的表面贴装器件（SMD）或倒装芯片贴装工艺。

### Welco AP519的优势

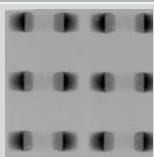
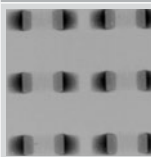
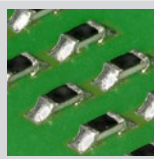
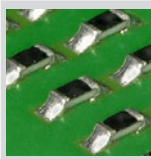
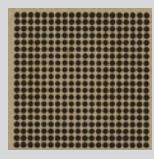
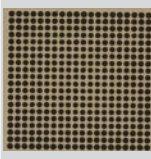
- 使用高质量Welco SnBiAg1 T6号锡粉
  - 粒度分布集中
  - 锡粉球形度好
  - 不同批次的产品性能一致
- 回流焊峰值温度低 (170 °C)
- 极低空洞率
- 在细间距印刷中焊锡膏脱模性极佳
- 钢网使用寿命长 (≥8小时)，印刷后作业时间长 (≥8小时)
- 回流后，无色残留



### 应用 / 工艺



## 钢网使用寿命测试

8小时连续印刷	0小时	8小时
<b>空洞率 (&lt;10%)</b> 01005器件贴装和回流焊 X-射线检测		
<b>无桥连和立碑缺陷</b> 01005器件贴装和回流焊 光学检测		
<b>在细间距印刷中锡膏脱模性能稳定</b> 钢网开孔: 100μm 线间距: 50μm 铜基板覆有机阻焊层		

## 产品特性表

物理特性	AP519
合金	Sn42/Bi57/Ag1
焊粉类型	6号Welco焊粉
卤素含量	无卤素
助焊剂类型	免清洗型 / 溶剂清洗型
粒径	5 - 15 μm
熔点	138 - 142 °C
应用	印刷

所有数据均为有效数据，贺利氏保留技术变更的权利。

美洲

电话 +1 610 825 6050  
electronics.americas@heraeus.com

亚太区

电话 +65 6571 7649  
electronics.apac@heraeus.com

中国

电话 +86 53 5815 9601  
electronics.china@heraeus.com

欧洲、中东和非洲

电话 +49 6181 35 4370  
electronics.emea@heraeus.com

本文所述事实与技术数据均由贺利氏利用最新知识和现代实验设备根据通用实验流程测定得出。文中信息均为出版前最新版本（可索要最新版本文件）。尽管数据均准确无误，但贺利氏对上述数据是否得到合理引用或因引用上述数据导致的任何侵权后果均不承担任何责任（除非事先以协议的形式征得明确的书面同意）。使用者应根据本文所提供的数据针对特定应用对材料适用性进行测试。贺利氏标识、贺利氏、Heraeus和Welco®图形商标均为贺利氏集团或其附属公司的商标或注册商标。保留所有权利。